

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等債券不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述該等債券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等債券不會於美國公開發售。



## Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：981)

### 建議發行債券

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

J.P.Morgan

ICBC  工銀國際

 BARCLAYS

 UBS

聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

 浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL

## 建議發行債券

本公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。債券現正根據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。

J.P. Morgan、工銀國際、Barclays、UBS及浦銀國際為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。債券定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過聯席牽頭經辦人協調的累計投標方式釐定。於本公告日期，建議發行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待釐定。於最終確定建議發行債券的條款後，預期本公司及聯席牽頭經辦人會訂立認購協議及與建議發行債券有關的其他輔助文據。

本公司擬將所得款項淨額用作擴充產能的資本開支及其他一般公司用途。

在建議發行債券方面，本公司將向若干專業投資者提供有關本集團的若干公司及財務資料，而該資料先前或未有必要公開。為了向股東及投資團體公平、有效和及時分發資料，有關資料摘錄隨附於本公告，及本公告將可在本公司網站([www.smics.com](http://www.smics.com))查閱。

本公司將就債券於新加坡證券交易所上市及報價提出申請。新加坡證券交易所並不就本公告中所作出的聲明或發表的意見是否正確一事上負上任何責任。本公司將就債券於新加坡證券交易所上市及報價提出的申請對本公司或債券的優點概無指示性。

因於本公告日期並無就建議發行債券訂立具有約束力的協議，建議發行債券未必會落實。完成建議發行債券須待若干條件達成後方可作實，包括但不限於全球市場狀況及投資者興趣。務請投資者及股東於買賣本公司證券時審慎行事。

本公司將於適當時候另行刊發有關建議發行債券的公告。

## 建議發行債券

本公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。債券並無且不會根據證券法登記註冊，且在若干例外情況的規限下，不得於美國境內提呈發售或出售。債券現正根據證券法S規例在美國境外發售及出售。

J.P. Morgan、工銀國際、Barclays、UBS及浦銀國際為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。債券定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過聯席牽頭經辦人協調的累計投標方式釐定。於本公告日期，建議發行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待釐定。於最終確定建議發行債券的條款後，預期本公司及聯席牽頭經辦人會訂立認購協議及與建議發行債券有關的其他輔助文據。

債券並無且不會根據證券法登記註冊，且在若干例外情況的規限下，不得於美國境內提呈發售或出售。債券將根據S規例於美國境外提呈發售及出售。債券將於香港向專業投資者發行。債券不會於香港向公眾人士提呈發售或出售，亦不會向本公司任何關連人士配售。

在建議發行債券方面，本公司將向若干專業投資者提供有關本集團的若干公司及財務資料，而該資料先前或未有必要公開。本公告將可在本公司網站([www.smics.com](http://www.smics.com))查閱。

## 所得款項建議用途

本公司擬將所得款項淨額用作擴充產能的資本開支及其他一般公司用途。

## 上市

本公司將就債券於新加坡證券交易所上市及報價提出申請。新加坡證券交易所並不就本公告中所作出的聲明或發表的意見是否正確一事上負上任何責任。本公司將就債券於新加坡證券交易所上市及報價提出的申請對本公司或債券的優點概無指示性。債券獲准於新加坡證券交易所上市及報價對本公司、本集團、其附屬公司、其聯營公司及債券的優點概無指示性。只要債券於新加坡證券交易所上市並且按照新

加坡證券交易所規定的規則，債券於新加坡證券交易所交易最少的買賣單位為200,000新加坡元(或其他貨幣的等值)。

## 有關本公司的資料

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本公司總部位於上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠，以及一座控股的300mm先進制程晶圓廠在建設中；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。本公司還在美國、歐洲、日本和中國台灣設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。

## 一般事項

因於本公告日期並無就建議發行債券訂立具有約束力的協議，建議發行債券未必會落實。完成建議發行債券須待若干條件達成後方可作實，包括但不限於全球市場狀況及投資者興趣。務請投資者及股東於買賣本公司證券時審慎行事。

本公司將於適當時候另行刊發有關建議發行債券的公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Barclays」	指	Barclays Bank PLC；
「董事會」	指	董事會；
「債券」	指	本公司建議發行的美元債券；
「本公司」或「我們」	指	中芯國際集成電路製造有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市；

「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及聯屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「工銀國際」	指	工銀國際證券有限公司；
「聯席牽頭經辦人」	指	J.P. Morgan、工銀國際、Barclays、UBS及浦銀國際；
「J.P. Morgan」	指	J.P. Morgan Securities plc；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)；
「建議發行債券」	指	建議發行債券(如本公告所述)；
「S規例」	指	證券法項下S規例；
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元；
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)；
「新加坡證券交易所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.004美元的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「浦銀國際」	指	浦銀國際融資有限公司；
「UBS」	指	UBS AG香港分行；

「美國」 指 美利堅合眾國；  
「美元」 指 美國法定貨幣美元；及  
「%」 指 百分比。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書  
高永崗

中國上海  
二零二零年二月十九日

於本公告日期，董事分別為：

**執行董事**

周子學 (董事長)  
趙海軍 (聯合首席執行官)  
梁孟松 (聯合首席執行官)  
高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

**非執行董事**

陳山枝  
周杰  
任凱  
路軍  
童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown  
叢京生  
劉遵義  
范仁達  
楊光磊

\* 僅供識別